

CircuitWorks® 无铅助焊膏

产品描述

CircuitWorks® 无铅助焊膏是一款 ROL0 型助焊膏，设计用于高可靠性、稳定性和洁净度的 BGA 返修，尤其是更高温度的无铅焊接的 BGA 返修。当 PCB 移动时，CircuitWorks® 无铅助焊膏的凝胶成份可在板子移动的情况下保持 BGA 元件固定。低粘度使得使用方便。本产品不含离子物质。CircuitWorks® 无铅助焊膏在净化室适用。

- 优秀的润湿能力
- 设计用于高温环境
- 粘着时间长
- 无腐蚀，无卤素或卤化物
- 符合 IPC 对 ROL0, No Clean 的要求
- 一致性好
- 粘度稳定
- 符合 ISO 9454
- 符合 Bellcore TR-NWT-000078 要求
- 符合 DIN EN 29454-1 1.1.3.C 的分类

典型应用

CircuitWorks® 无铅助焊膏可用于包括如下的电子应用：

- BGA 返修和维修
- BGA 植球
- 表面贴装器件焊盘
- 开关
- 插座

主要技术数据和物理性能

性能

助焊剂类型	免清洗 ROL0
闪点 (TCC) °F)	>140°C (284
外观	浅黄色
气味	轻微的

符合 RoHS



兼容性

CircuitWorks® 无铅助焊膏与电子行业中使用的绝大多数物料兼容。对于任何化学产品，与材质的兼容性必须在使用前在非重要部位测试而定。

使用指导

只适用于工业用途

使用前请仔细阅读MSDS

助焊膏应用：CircuitWorks®无铅助焊膏应仅用于电路板的BGA返修区域，不适用于整个电路板。从注射器上取下盖子并且轻压活塞，将助焊膏涂在BGA返修区域。可使用Control Wipe™干擦拭布擦除针头的残留物。

清洗：焊接后的无铅助焊膏残留不需要清除。但如果有需要，可以去除。Chemtronics Flux-Off® No Clean Plus是一款理想地有效去除助焊剂残留的清洁剂。

技术和应用支持

ITW Chemtronics®向用户提供技术热线，用于解答用户的技术问题和应用问题。

免费电话1-800-TECH-401

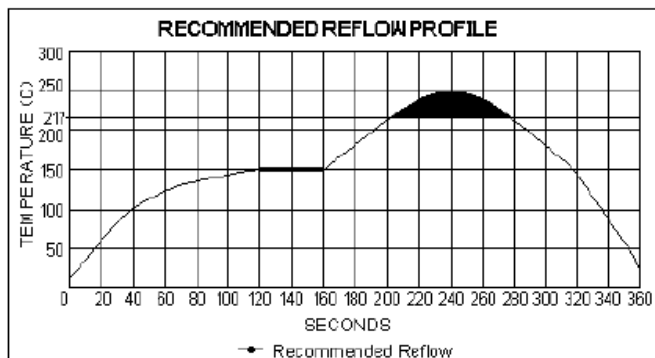
产品型号：

CW8700

3.5g (0.12 oz) 注射器包装

CW8710

12gm EFD 涂覆器



环境影响数据

ODP	无	VOC	无
HCFC	无	HFC	无

臭氧耗散潜能值 (ODP)，是根据Montreal Protocol and U.S. Clean Air Act of 1990而定。碳氢氯氟化合物(HCFCs)，根据蒙特利尔公约被归类为2级臭氧消耗物质。挥发性有机化合物 (VOC)，是根据如下规则对VOC的定义在重量基础上计算而得。规则有：California Air Resources Board (CARB) Consumer Product Regulations, South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 102 and the Federal definition published in 40 CFR 51.100(s)。碳氢氟化物(HFC)目前还未被管制。

注明：

以上信息被认为是正确的，是为专业的、有能力来正确评估和使用这些数据的终端用户而准备的。

ITW Chemtronics®不保证这些数据的精确性，对在使用过程中发生的损坏不承担责任。

MANUFACTURED BY:

ITW CHEMTRONICS

8125 COBB CENTER DRIVE

KENNESAW, GA 30152

1-770-424-4888

REV.B (11/11)

Chemtronics Flux-Off®和CircuitWorks®为ITW Chemtronics 的注册商标，保留所有权利。

Control Wipe™ 为ITW Chemtronics 的商标，保留所有权利。

DISTRIBUTED BY: